

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## 芯海科技（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他		
日期/时间	2025年4月9日 15:00-16:30	地点	公司会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司在 AI 落地方面有什么新的战略布局吗？</b></p> <p>公司回答：在云端，芯海科技和子公司康柚健康希望与合作伙伴一起，以芯片与算法为核心优势，借助 AI 大模型进行数据分析，预测和评估千万用户的健康状况，为用户推送健康信息前瞻提示，助力运动与饮食干预，推动健康生活方式养成。</p> <p>在边缘端，智能边缘设备与 AI 技术逐步融合。边缘 AI 离客户更近，出于数据隐私与资产保护考量，众多企业用户不愿将数据传至云端，倾向私有化部署数据中心，边缘 AI 正好契合这一需求。能实现定制化、个性化，以低时延、高响应特性，更好匹配场景要求。</p> <p>在应用终端，AI 技术赋予了各种终端设备更智能化的特性，作为重要的生产力工具，AI 应用的落地需要硬件的承载，与各行各业结合，赋能千行百业。在智能汽车、人形机器人、工业物联网、医疗健康等领域，行业应用爆发，从“万物互联”迈向“万物智联”。各类新型智能终端的快速发展，催生了万亿级芯片增量市场，芯片功能从“通用化”转向“场景定制化”。</p> <p>公司将加大 AI 技术方面投入，结合 ADC、MCU 双平台优势，围绕通信与计算机、机器人、工业高精度测量和汽车等方向布局。公司积极配合 AI 技术落地不断创新，围</p>		

绕“云边端”协同和落地，与下游生态深度绑定，为垂直场景提供“芯片+算法+数据”全栈方案，力求在市场中占据领先地位，实现企业的快速发展。

**2、有关人形机器人的内容可以具体展开讲讲吗？公司在研发人形机器人或电子皮肤相关产品中具有什么竞争优势呢？**

公司回答：人形机器人对半导体的集成度、智能化和感知水平提出了更高要求。在机器人领域，围绕电子皮肤、六维力传感器等关键应用，公司已与相关客户展开探索与合作。例如，ADC 是电子皮肤的底层技术之一，高精度 ADC 能将微小压力变化精准数字化，避免信号模糊。芯海 ADC 具有高精度、高线性度、低温漂等特性，且布局广泛、应用场景众多。机器人的感知、决策、执行等动作需要电子皮肤、六维力传感器、空心杯电机等设备作为基础桥梁，而这些设备的精确运转离不开对应的高精度 ADC、MCU、触觉反馈芯片、传感器调理芯片、压力触控芯片等硬件的支持。

**3、公司在 PC 业务的布局规划？产品的核心竞争力来自于哪里？**

公司回答：AI 带来算力需求迅猛增长，带来了满足海量数据计算的高性能处理器芯片需求，公司基于自身深厚的技术积累，已实现了以 EC 为核心，覆盖 PD、HapticPad、USB 3.0 HUB、BMS 的横向产品布局；同时，也完成了从 AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的 EC、SIO、edge BMC 的纵向产品布局。公司 EC 是大陆首个通过 Intel 国际认证的 EC 产品，同时也通过了计算机全球龙头企业验证，打破了海外产品对于此市场的垄断，能够满足各种品类计算机的需求，目前已经完成和国内外各大主流笔记本厂家的适配工作。荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于报告期内发布，该产品搭载了芯海科技高性能 EC 芯片；USB 3.0 HUB 产品已在客户端实现量产；应用于台式计算机的第一代 Super IO 产品已经导入客户端。截至 2024 年年末，EC 累计出货量近 1,000 万颗。

随着 AI 大模型的衍生应用不断推出，许多终端开始升级智能化体验，从而产生了海量的终端数据分析处理需求。企业的业务部署场景和数据产生正在向端侧、边缘侧“迁移”。公司针对边缘计算及服务器市场的轻量级 edge BMC 管理芯片，已经上市并开始导入客户端。

公司凭借 20 余年高精度 ADC 技术积累及高可靠性 MCU 技术壁垒，构建了覆盖从计算机到服务器领域的全系列产品，并进入荣耀、Intel 等头部客户供应链。通过“感知+计算+连接+算法”全栈技术整合和生态协同，形成深度客户黏性。未来，公司仍

将坚持以“驱动计算、服务计算”为方向，助力 PC 从“生产力工具”进化为“智能伙伴”，与行业伙伴共同开启 AI 时代 PC 的无限可能。

#### 4、请问公司的鸿蒙生态布局规划？

公司回答：芯海是鸿蒙的生态合作伙伴。芯海注重技术创新和研发投入，在能力、产品、商业布局上的突出亮点包括强大的模拟芯片和 MCU 设计能力，以及针对物联网市场的全面解决方案，基于此，公司持续向轻量级设备领域厂商提供具有市场竞争力的创新产品。此外，作为轻量级设备领域与鸿蒙生态互联互通的桥梁，公司不仅提供产品，还提供使能服务，帮助中小企业更好地融入鸿蒙生态。通过软硬服务一体化与鸿蒙合作，在开源鸿蒙中参与标准建设及共创，例如智能仪表产品的出货量稳定上升。随着鸿蒙连接数和品类的不断增长和扩展，我们看到鸿蒙生态系统正在不断壮大和完善。

截至 2024 年末，公司已成功导入 300 余个鸿蒙智联项目商机，完成 115 个 SKU 的产品接入，终端产品累计出货量近 4,000 万台。在电力细分市场，公司通过了电鸿模组认证。2025 年，公司成功进入“鸿蒙智联推荐模组”名单。

#### 5、面对半导体行业的外部压力和技术封锁以及近期一系列黑天鹅事件，公司供应链稳定性如何保障？

公司回答：公司坚持走自主创新之路，核心产品基本实现全国产化供应链，相关风险较低。目前公司在手机、笔记本电脑、无人机等领域，突破了长期被海外企业垄断的市场，已有多款芯片成功实现了国产替代，如高精度 ADC 芯片，EC 系列芯片，PD 芯片，BMS 芯片，传感器调理芯片等。

一直以来，公司高度重视供应链能力建设，在供应商选择上与产业链领先的厂商合作，并与上游晶圆制造商、封装测试厂商建立高效的联运机制与长期稳定的合作关系。公司积极建立产品多源供应的供应链体系，有利于公司供应链安全，且能有效的保障公司产能供给，降低产能波动对公司产品交付及时性的影响。面对近期一系列黑天鹅事件，公司将持续紧抓“国产替代”的发展机遇，积极做好各项工作，基于对细分市场及应用场景的深刻理解，以更创新的产品及优质服务来满足用户需求，在战略主航道内逐步实现国产替代。

#### 6、公司 2024 年营收创历史新高，但归母净利润仍亏损，主要原因是什么？

公司回答：2019 年，根据国内外形势的变化，公司战略进行了重大调整，从传统的

	<p>中低端消费电子向汽车电子、计算机与通信、手机、BMS、工业控制等高端领域转型。其中核心的产品都是性能较高的 SOC 类产品，应用场景复杂，技术难度大，可靠性要求高，研发周期长，因此研发投入有较大幅度增长。经过几年的战略投入，2022 年底开始，公司相关产品开始陆续推出，并在手机、PC、无人机等领域的头部客户取得突破，新产品的销售量和销售额都持续上升，因此 2024 年，得益于前期战略投入的成果逐步显现，叠加公司通过深化品牌价值与核心客户的战略合作，同时依托上游产业链的充足产能保障。2024 年公司实现营业收入 7.02 亿元，同比上年增长 62.22%，实现归属于上市公司股东的归母净利润-17,287.36 万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄 9,169.48 万元。亏损主要由于股份支付费用较高（研发费用剔除股份支付后同比增长 8.01%）。</p> <p><b>7、2024 年毛利率提升至 34.18%，主要驱动因素是什么？这一趋势能否持续？</b></p> <p>公司回答：随着前几年的战略布局，2024 年，随着业绩持续增长，产品结构发生了变化，毛利率提升源于新品占比提升。2025 年，将随着前期战略投入的产出继续显现，持续优化产品结构，有望对毛利率带来积极贡献。</p>
附件清单 (如有)	/
以下本次活动参与人员签字页	
参与单位 名称	线上参与公司 2024 年年度报告投资者交流说明会的投资者
上市公司 接待人员 姓名	董事、副总经理 万 巍 董事、财务总监 谭兰兰 董事会秘书 张娟苓